

中信证券股份有限公司
关于贵州振华风光半导体股份有限公司
2024 半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“振华风光”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2024 年 8 月 5 日对公司进行了募集资金半年度现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

- （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；
- （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度；
- （3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件；
- （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、公司出具的 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
- （5）对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

(一) 核心竞争力风险

1、研发未达预期风险

公司围绕市场需求，开展核心技术研发、新产品拓展、技术升级改造等工作，投入了大量的资金和人力，公司技术成果的产业化和市场化进程具有不确定性，如果在研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期，或者研发出的产品未能得到市场认可，公司将面临前期的研发投入无法收回且难以实现预计效益的风险，并将对公司业绩产生不利影响。

2、研发人员不足或流失的风险

集成电路行业是技术密集型行业，关键技术和人才是公司保持持续竞争优势的基础，随着技术研发的深入，技术创新在深度和广度上都将会更加困难。这就需要公司在技术研发方面不断加大投入，同时加大对高端、复合型技术人才的引进。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，或者出现研发人员流失的情况，都将会导致公司的竞争力下降。

(二) 经营风险

1、客户集中度较高风险

报告期内，由于公司下游客户主要以国有集团的下属单位为主，使得公司以同一集团合并口径的客户集中度相对较高。虽然公司与主要客户形成了密切配合的合作关系，按照特种元器件供应的体系，通常定型产品的供应商不会轻易更换，且公司积极研发满足现有客户需求的新产品、积极拓展新客户、开拓新市场，减少客户集中度高的潜在不利影响。但若公司在新业务领域开拓、新产品研发等方面进展不利，或现有客户需求大幅下降，则较高的客户集中度将对公司的经营产生影响。

2、税收政策变动的风险

国家一直以来重视集成电路企业的政策支持，公司作为高新技术企业，享受着国家税收政策优惠，但是未来若国家相关税收优惠政策发生变化，将会对公司经营业绩带来不利影响。

（三）财务风险

1、应收账款及应收票据余额较高的风险

报告期公司业务规模不断扩大，应收账款及应收票据的余额仍处于较高水平。公司主要产品应用于海、陆、空、天、网等核心领域，由于集成电路处于高可靠领域产业链配套末端，配套产品验收程序严格和复杂，结算周期较长，同时受客户主要集中在年末付款且以商业承兑票据结算为主的影响，导致公司销售回款速度慢，应收账款、应收票据规模较大。公司的下游客户主要为央企及其子公司，整体信誉较好，支付能力较强。但若公司不能有效提高应收票据及应收账款管理水平及保证回款进度，将有可能出现应收票据及应收账款持续增加、回款不及时甚至坏账的情形，从而对公司经营成果造成不利影响。

风险管理措施：针对公司业务的特点，公司在签订销售合同时将持续加强对合同签订方经营状况及信用调查，合理制定客户的信用额度；进一步优化应收账款回款激励机制，加大应收账款的催收力度，并严格按照坏账计提政策计提坏账准备，全力降低应收账款不能回收的风险。

2、存货金额较大及发生减值风险

报告期随着公司业务规模的不断扩大，为满足生产经营需要，公司存货仍处

于较高水平。受产品种类型号多、验收程序繁琐等因素的影响，公司储备的原材料较大，客户尚未验收的发出商品余额较大，导致存货余额较高。同时，公司积极应对客户的需求，提升生产灵活性，结合市场供需情况及预期客户的需求，对部分产品提前备货。若公司无法准确预测客户需求并管控好存货规模，将增加因存货周转率下降导致计提存货跌价准备的风险。

风险管理措施：一方面公司将坚持采用“以销定产、以产定购”的计划型采购模式，对存货规模进行严格控制，同时加强销售队伍建设，不断完善客户需求分析管理体系，合理备货；另一方面严格按照政策定期计提存货跌价准备，以减少存货跌价风险。

（四）行业风险

1、需求端的放缓或调整，引起市场竞争格局变化，价格成本控制更加敏感，供应链的稳定性和需求预测变得更加重要。

2、下游需求及产品销售价格波动风险，如未来受行业环境因素的影响，如果高可靠集成电路的下游市场需求出现一定波动，或者因市场竞争加剧导致产品销售价格有所下降，从而对公司销售收入及毛利率等经营业绩指标造成不利影响。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年半年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2024年1-6月	2023年1-6月	本期比上年同期增减(%)
营业收入	61,056.89	64,740.74	-5.69
归属于上市公司股东的净利润	23,129.64	25,655.35	-9.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,685.61	25,235.99	-14.07

经营活动产生的现金流量净额	-4,584.16	2,546.77	-280.00
主要会计数据	2024年6月末	2023年6月末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	481,965.19	472,895.55	1.92
总资产	542,429.59	536,046.77	1.19
主要财务指标	2024年1-6月	2023年1-6月	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.1565	1.2828	-9.85
稀释每股收益(元/股)	1.1565	1.2828	-9.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.0843	1.2618	-14.07
加权平均净资产收益率(%)	4.80	5.94	减少1.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.50	5.84	减少1.34个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	11.68	11.45	增加0.23个百分点

(1) 营业收入同比下降 5.69%，主要系税收优惠政策变更及产品降价影响所致。

(2) 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别下降 9.84%、14.07%，主要系税收优惠政策变更及产品降价使毛利率下降，同时应收款项计提的信用减值准备增加所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 7,130.93 万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金大量减少，同时支付的税金大幅增加所致。

(4) 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别下降 9.85%、9.85%、14.07%，主要系税收优惠政策变更及产品降价影响使毛利率下降，同时应收款项计提的信用减值准备增加，导致本期净利润同比下降所致。

(5) 研发投入占营业收入的比例同比增加 0.23 个百分点，主要系本期营业收入同比减少所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

1、研发方面

公司多年来致力于模拟集成电路的设计以及相关技术的研究，立足国产化的需求和创新，在模拟芯片领域积累了大量的技术经验，通过建立器件仿真与电路设计有效结合的研发模式，指导定制化器件在复杂芯片设计中的应用；完善从芯片设计、测筛、辐照试验验证的全流程抗辐照产品研发及芯片抗总剂量评价体系；注重算法设计与建模分析，逐步建立自上而下的全正向研发流程与设计能力，提高核心竞争力，实现从设计到封装测试完全自主可控的研发流程；积极与复旦大学等高校进行合作，通过共建联合实验室，进一步强化产学研合作关系，引导技术水平正向发展。另外，公司目前已具备高性能放大器、fA 级超低漏供电模拟开关、高增益达林顿驱动、三相 H 桥驱动、LVDT 信号调理、反激/有源嵌位/半桥/堆叠式 PWM 控制器，risc-V 嵌入式 MCU、智能电机驱动、高性能射频等产品设计研发能力，使公司从单一产品供应商转变为系统级供应商，能够为客户提供更加全面的系统解决方案。

2、制造方面

公司在 GJB9001C 质量管理体系的基础上，深化新时代质量管理体系建设，并且获得 3 级-认定，在特种元器件行业质量管理水平国内领先，公司非常重视产业链管理，以协同全产业链质量管理模式向行业推广应用，荣获了 2023 年全国质量标杆称号。

公司在高可靠产品的生产工艺和质量控制体系方面，拥有持续稳定的可靠性技术及 10 余年数据积累，建立的模型数据库可以辅助高可靠设计技术攻关，解决用户特种环境下如低轨卫星、国家电网等高压、高湿、辐射、强磁场等恶劣环境中产品的长期可靠性等问题，市场稳固且具有良好的延续性。

在封装方面，新建的 WBBGA 和 FCBGA 生产线也已经实现全线贯通。当前已具备金属封装、陶瓷封装和塑料封装三大封装工艺平台，封装种类覆盖 SOP、QFN、QFP、BGA 等十多个类型一百多个品种，最高引出端数达 2000PIN，高工作频率可达 40GHz，具备高密度、高可靠的单芯片封装，多芯片叠层封装和 SiP

系统级封装能力。

在集成电路测试方面，实现多种高速逻辑电平测试、协议接口数据处理等测试技术，相关参数如时间参数测量达到了百 ps 水平，自主开发高速数模转换器配置软件。

3、市场方面

公司作为国内最早从事模拟集成电路研发和生产的厂商之一，品牌客户资源丰富，公司持续加大市场技术团队的构建，覆盖了产品推荐、应用优化、分析改进、产品定义、整体方案咨询等方面，业务响应范围和速度更快，极大提升用户的感知度。报告期内共有 60 余款新产品成功推向用户，进一步夯实公司新产品的市场布局，通过 FAE 售前技术支持，为用户提供一站式系统解决方案，更具竞争力和韧性。

4、人才方面

公司通过优秀的企业文化吸引人才、留住人才、凝聚人才，公司的人才结构不断优化，实现技术和管理双向融合。公司拥有集成电路行业内优秀的技术、研发和管理团队，在模拟、混合集成电路的设计和产业化方面积累了丰富经验，并在“贵阳+成都”基础上，建立西安、南京、上海研发中心，为公司可持续发展提供有力保障。

5、企业文化

公司围绕“拼搏奉献、担当务实、创新发展、卓越共赢”的核心价值观，创立良好的企业文化环境，并指导员工在具体行动中实践公司“科技为先、质量为本、用户至上、诚信共赢”的经营理念。公司始终做到以人为中心，把员工视为文化建设的主要对象和企业的最重要资源，通过不断调动员工的积极性和创造性，实现员工自身价值的升华和企业蓬勃发展的有机统一。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未

发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	变化幅度（%）
费用化研发投入	7,129.41	7,409.89	-3.79
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	7,129.41	7,409.89	-3.79
研发投入总额占营业收入比例（%）	11.68	11.45	增加0.23个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

2024年1-6月，公司研发投入总额占营业收入的比例为11.68%，同比增加0.23个百分点，基本保持稳定。

（二）研发进展

报告期内，公司形成了一种参考电压浮动的控制电路、一种功率放大器限流保护设计及其电路和集成结构、基于LC网络的低噪声放大器输入驻波优化电路及方法等新技术专利，共计申请发明专利17件、软件著作权1件、集成电路布图设计16件；已授权发明专利2件、实用新型专利1件、软件著作权1件、集成电路布图设计16件。公司以专用转换器方向成果为牵引，荣获贵州省科技进步二等奖。

报告期内获得的知识产权列表：

类型	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	17	2	111	38
实用新型专利	0	1	86	83
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	1	1	5	5
其他	16	16	191	173
合计	34	20	393	299

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，公司于 2024 年 3 月审议通过了募投项目延期的议案，募集资金投入进度相比原计划有所延后，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况如下：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东为中国振华电子集团有限公司，持有公司 40.12% 的股份。公司实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司，其通过持有中国电子有限公司与中国振华股权间接控制振华风光 40.12% 的股份，并通过中电金投间接控制振华风光 2.92% 的股份，合计控制振华风光 43.04% 的股份。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人所持有的公司股份不存在质押、冻结及减持的情形。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未直接持有公司股票，通过员工持股平台贵州风光智管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“风光智”）及贵州风光芯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简

称“风光芯”）间接持有公司股票情况如下：

序号	姓名	任职情况	间接持股情况	质押或冻结情况
1	朱枝勇	董事长	无	无质押或冻结
2	张国荣	董事长（离任）	持有风光芯 6.04%的出资份额	无质押或冻结
3	赵晓辉	副董事长	持有风光智 5.44%的出资份额	无质押或冻结
4	胡锐	董事、总经理、董事会秘书、核心技术人员	持有风光智 4.35%的出资份额	无质押或冻结
5	刘宗永	总法律顾问	持有风光芯 4.83%的出资份额	无质押或冻结
6	刘岗岗	副总经理	持有风光芯 4.83%的出资份额	无质押或冻结
7	唐拓	副总经理	持有风光智 4.35%的出资份额	无质押或冻结
8	段方	副总经理	持有风光智 2.99%的出资份额	无质押或冻结
9	刘健	副总经理	持有风光芯 4.83%的出资份额	无质押或冻结
10	张博学	总会计师	持有风光芯 1.51%的出资份额	无质押或冻结
11	李政	核心技术人员	持有风光智 2.31%的出资份额	无质押或冻结
12	李平	核心技术人员	持有风光智 1.73%的出资份额	无质押或冻结
13	唐毓尚	核心技术人员	持有风光智 3.27%的出资份额	无质押或冻结
14	夏良	核心技术人员	持有风光智 1.16%的出资份额	无质押或冻结
15	李雪	核心技术人员	持有风光智 1.16%的出资份额	无质押或冻结

注 1：公司高级管理人员和部分核心员工参与认购的中信证券振华风光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已于 2023 年 8 月 28 日上市流通；自上市流通后，该资管计划累计减持公司 3,713,333 股，截至 2024 年 6 月 30 日，该资管计划已不持有公司股份。

注 2：截至 2024 年 6 月 30 日，风光智直接持有公司股份 3,869,867 股，风光芯直接持有公司股份 3,486,239 股。

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在其他质押、冻结及减持情况。

十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

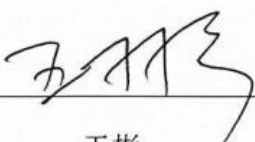
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 半年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人：



马峥



王彬

